

Opravářské pracoviště BGA Hakko FR-811 sestava L

Obj. číslo:	102004044
Dostupnost:	4 - 8 týdnů



Popis

Profesionální opravářské pracoviště určené pro rework BGA a dalších komponent. Sestava obsahuje horkovzdušnou stanici HAKKO FR-811, spodní předehřev C5023, držák na DPS C5027 a stojan na horkovzdušnou stanici C5028.

Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/opravarske-pracoviste-bga-hakko-fr-811-sestava-l/?videos=1>

Obsah balení

- FR-811 SMD opravárenská stanice.
- CD se softwarem a ovladačem (kompatibilní pouze s Windows 7).
- Držák C5033.
- Vakuová pipeta B3023.
- USB kabel.
- Termočlánek.
- Tepelně odolná deska.
- Napájecí kabel.
- Vakuové násadky, průměr 3, 5, 7 mm (2 ks od každé velikosti).
- Držák na DPS C5027.
- Stojan pro horkovzdušnou stanici C5028.
- Spodní předehřev C5023.
- Manuál.
- Součástí balení nejsou odpájecí trysky, nakupují se zvlášť (viz záložka Příslušenství).

Technická data

Název parametru	Hodnota
Napájení	220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Příkon	1200 W
Rozsah teplot (minimální)	50 °C
Rozsah teplot (maximální)	600 °C
Teplotní profil	ano

Doporučená max. velikost DPS	248 x 140 mm
Opakovatelnost procesu	zdokumentovaná, řízená
Stlačený vzduch	max. 115 l/min
ESD provedení	ano
Obsah balení	horkovzdušná stanice HAKKO FR-811, spodní přehřev C5023, držák na DPS C5027, stojan C5028
Typ spodního přehřevu	hybridní
Typ horního ohřevu	horký vzduch/plyn
Určeno pro opravy	mobilní telefony, tablet, laptop, herní konzole, Wii, Xbox, PC základní desky, průmyslové, náročné vícevrstvé DPS
Velikost ohřevné plochy	190 x 80 mm
Výkon spodního přehřevu	730 W
Optická kontrola procesu	bez kamery
Software	monitorovací software, profilovací software
Proces opravy	plně ruční oprava
Procesní kamera	ano (volitelně)
Opravované součástky	SMD, SO, SOIC, QFP, PLCC, BGA, reballing BGA , vývodové součástky
Výrobce	Hakko